

NUMBER 179277



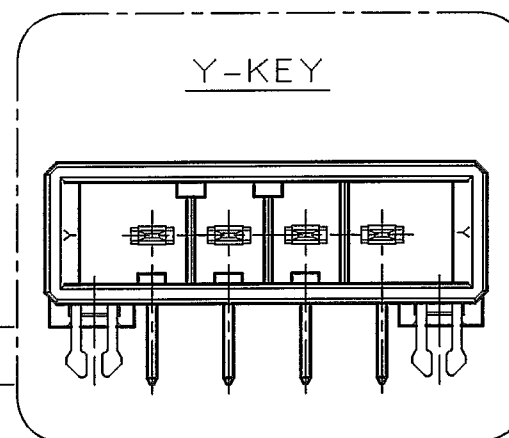
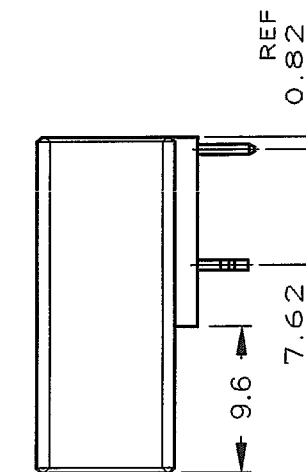
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

回路番号
CIRCUIT NOAMPマーク
シリーズマーク
SERIES MARKタブコンタクト
TAB CONTACTリテンションレグ
RETENTION LEGコンタクト半田付部
CONTACT TAIL

△6	△4	2-179277-5	Y
△6	△3	2-179277-3	Y
△6	△2	2-179277-2	Y
△6	△4	1-179277-5	X
△6	△3	1-179277-3	X
△6	△2	1-179277-2	X
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)	KEY



NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO
PLASTIC,POLYESTER
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY

△2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING
OVER NI PLATING

△3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING
OVER NI PLATING

△4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN
PLATED OVER NICKEL

△5. FINISH(RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

△6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING4-φ1.1
DIA 1.1±0.1 4PLACESスルーホール 2-φ3
DIA 3±0.1 2PLACESラウンド 2-φ4MIN
ROUND DIA 4MIN 2PLACES

推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚:1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注記

1. 材料:ハウジング: ガラス入り熱可塑性

ポリエステル樹脂

コンタクト: 銅合金

リテンションレグ: 銅合金

△2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地

接触部: 0.38μm MIN金めっき

△3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地

接触部: 0.76μm MIN金めっき

△4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地

接触部: 2.0 μm MINスズめっき

△5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部

ニッケル下地の土に半田めっき

△6. めっき リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の土にスズめっき

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME	4 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200			
mm ² (AWG -)		mmφ		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	NUMBER
MATERIAL		FINISH		10mm以下 : ±0.3	A3	J	179277
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		10mm超 30mm以下 : ±0.4	SCALE		REV.
DR. 10 DEC 93 N. Matsubara		DE. 10 DEC 93 N. Matsubara		30mm超 100mm以下 : ±0.5	2-1		D1
CHK. 13 DEC 93 S. MANABE		APP. 13 DEC 93 S. MANABE		角 度 : ±3°	SHEET		1 OF 1